

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	鹏华基金、富荣基金、国投证券自营、先锋基金、海港人寿、红土创新基金、广发资管、第一创业证券、中山证券资管、玄元投资、创金合信基金、中信资管、恒悦资产、华西证券、恒生前海基金、国信证券自营、中泰证券、华创证券
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025年1月10日
地点	公司会议室、华创证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>Q2、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。</p> <p>Q3、请介绍公司 2024 年前三季度 PCB 业务在通信市场经营拓展情况。</p> <p>2024 年前三季度，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出</p>

现明显改善，有线侧 400G 及 800G 高速交换机、光模块产品需求在 AI 相关需求的带动下有所增长。

Q4、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q5、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q6、请介绍公司在封装基板领域的产品布局情况。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。

Q7、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年持续快速提升，已承接部分产品订单。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。

Q8、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品

	<p>制造能力，其中 20 层产品送样认证工作亦有序推进中。</p> <p>Q9、请介绍公司 2024 年第四季度产能利用率情况。</p> <p>公司 2024 年第四季度综合产能利用率环比上季度保持平稳。</p> <p>Q10、请介绍请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024 年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末以来有所上浮，整体价格相对保持平稳。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>Q11、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。</p> <p>公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>